



NXP, ID 보안 및 내구성 혁신할 초박형 비접촉 칩 모듈 MOB10 출시

- 보안 및 기능이 한층 강화된 초박형 비접촉 칩 모듈 MOB10으로,
여권 및 신분증 설계 방식 혁신

주요 특징

- NXP, 두께 200 μ m 이하의 세계에서 가장 얇은 양산형 비접촉 칩 모듈 MOB10 선보여
- 폴리카보네이트 기술 지원으로 신분증에 보안 및 기능을 더해 안전한 신분증 구현 가능
- 검증된 MOB 산업 플랫폼 상에 구축할 수 있어, 추가적인 생산 투자 없이 긴밀한 전환 가능

2017년 10월 18일 - NXP 반도체(NXP Semiconductor)는 여권 및 신분증의 설계 방식을 혁신할 초박형 비접촉식 칩 모듈, MOB10을 발표했다. 인간의 머리카락보다 네 배나 얇은 200 μ m 두께의 MOB10은 이전 모델보다 20% 얇아 데이터 페이지나 신분증 등 초박형 인레이(ultra-thin inlays)에 이상적이다.

MOB10은 현재 출시된 모듈 중 가장 얇은 비접촉식으로, 새로운 보안 및 내구성 기능을 갖췄을 뿐만 아니라 폴리카보네이트(polycarbonate) 기술을 지원한다. 또한 기존 생산 라인과 호환되는 최초의 초박형 플랫폼으로, 제조사들은 리틀링 없이 이를 추가할 수 있다. 이로써 비용 부담이나 생산 차질없이 여러 제품을 지원할 수 있다.

새로운 초박형 MOB10은 e데이터페이지, e커버 및 신분증 인레이를 수정이나 위조가 어려운, 한층 얇고 안전한 형태로 만듦으로써, 전자 문서 위조를 방지하도록 설계되었다. 두께가 200 μ m으로 매우 얇아 여권이나 전자 신분증, e헬스 카드, 각종 신분증, 운전면허증 및 스마트 카드 등에 이것저것 설치할 필요 없이, 보안 마이크로컨트롤러와 안테나를 포함시킬 수 있고, 새로운 보안 기능을 추가할 수 있다.

여권의 경우 MOB10을 활용하면 기존에는 표지에 내장되어 있던 IC를 내부 페이지로 이동시킬 수 있다. 이러한 새로운 기능은 개인정보 침해 후 IC를 제거하거나 새로이 삽입하려는 시도를 차단해 한층 두터운 보안 기능을 제공한다. 또한, MOB10은 미세 균열을 줄이고 기계적/환경적 스트레스를 견디도록 설계되었으며, 리버스 엔지니어링이나 기타 보안 위협에 대한 취약성이 덜하다.



세바스티엔 클라마지랑(Sebastien Clamagirand) NXP 보안 ID 사업부 총괄은 “더욱 얇으면서 비용 효율적으로 신분증을 만드는데 필요한 미래의 임베딩 요건을 충족할 수 있는 초박형 솔루션 수요가 점점 더 많아지는 추세다. 세계에서 가장 얇은 비접촉 칩 모듈인 MOB10은 이와 같은 수요에 가장 잘 들어맞는 제품이다. 더욱 얇으면서 내구성과 보안 역량은 배가된 차세대 여권이나 신분증 제작을 가능케 해 준다” 고 말했다.

MOB10은 양산용으로 설계되었으며 릴(reel) 당 밀도가 한층 높아 기기 처리량이나 저장 공간을 최적화 해 신분증 제조사들이 비용은 절감하면서 운영 효율은 높이고 한층 내구성 있는 최종 제품을 제공하도록 한다. MOB10 솔루션은 ICAO 9303 및 ISO/IEC 14443 표준과 호환되어 탄력적인 사용이 가능하다.

NXP 웨비나 안내

MOB10에 대한 보다 자세한 사항은 11월 8일 수요일 오전 12시~8시(PST)에 진행되는 NXP 웨비나를 통해 만나볼 수 있다. [여기](#)를 통해 등록이 가능하다.

NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXP)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 33개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2016년 매출은 미화95억불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.